

研究評価委員会

第1回「次世代高度部材開発評価基盤の開発」(事後評価)分科会

日時：平成21年 8月20日(木) 10:30~17:30

場所：ダヴィンチ芝パークB館 地下1階

コンベンションホールAP浜松町 会議室B・C

(東京都港区芝公園2-4-1 TEL 03-5405-6109)

議事次第

【公開】

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. 開会、分科会の設置、資料の確認 | 10:30~10:40 (10分) |
| 2. 分科会の公開について | 10:40~10:45 (5分) |
| 3. 評価の実施方法 | 10:45~ |
| 4. 評価報告書の構成について | 10:55 (10分) |
| 5. プロジェクトの概要説明(説明40分、質疑応答30分) | 10:55~12:05 (70分) |

昼食(50分)

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 6. プロジェクトの詳細説明 | |
| 6.1 研究開発成果について(各説明10分、質疑応答8分) | 12:55~13:49 (54分) |
| (1) Low-k材料のダメージ耐性評価方法の開発 | |
| (2) 統合部材開発支援ツール(TEG)の開発 | |
| (3) パッケージ工程までの一貫した材料評価方法の確立 | |

休憩(11分)

【非公開、実施者入れ替え制】

- | | |
|---|--------------------|
| 6.2 実用化、事業化の見通しについて
(各説明7分、質疑応答7分、交代1分) ×11件 | 14:00~16:45 (165分) |
| 7. 全体を通しての質疑 | 16:45~17:00 (15分) |

休憩(10分)

【公開】

- | | |
|--------------|-------------------|
| 8. まとめ・講評 | 17:10~17:25 (15分) |
| 9. 今後の予定、その他 | 17:25~17:30 (5分) |
| 10. 閉会 | |

以上